

12.11.2024, Heidelberg

1. ISGATEC Engineering Summit**Dichten. Kleben. Polymer. – Gegenwart und Zukunft****Inkl. Abendveranstaltung am Vorabend**

Uhrzeit	Vortragstitel	Referent:in
08.30 - 09.00	Check-in	
09.00 - 09.10	Begrüßung	Sandra Kiefer, Holger Best und Sema Tatlıdede
09.10 - 09.30	Keynote Konstruktion von Dicht- und Klebstellen im Jahr 2024	Professor Dr. Herbert Baaser Technische Hochschule (TH) Bingen
09.30 - 10.00	Klebungen leichter auslegen mit calcbond Der Game-Changer in der Konstruktion und Berechnung von Klebverbindungen.	Fabian Nowacki ar engineers GmbH
10.00 - 10.30	Neue Dichtungslösungen Wirtschaftliche Ablösung für Gleitringdichtungen mit Sperrsystemen oder Wellenlippendichtungen.	Harald Tobies METAX Kupplungs- und Dichtungstechnik GmbH
10.30 - 10.50	Kaffeepause und Netzwerken	
10.50 - 11.20	Podiumsdiskussion Nachhaltige Konstruktion von Kleb- und Dichtstellen	Julia Kletschke meweo GmbH Dr. Marc Langela Stasskol GmbH Dr. Holger Fricke Fraunhofer IFAM
11.20 - 11.50	Eine Verbindung über die Grenzen hinaus Eine neue Klebeband-Technologie eröffnet konstruktive und produktionstechnische Freiheitsgrade.	Nelson Goncalves 3M Deutschland GmbH
11.50 - 12.50	BarCamp 1 Dichten BarCamp 2 Kleben	Alle
12.50 - 13.50	Gemeinsames Mittagspause und Netzwerken	
13.50 - 14.20	Batteriegehäuseabdichtung – auf und zu – just like that. . . Vorteile durch den Einsatz dauerplastischer Dichtstoffe für die Konstruktion, Fertigung und Reparaturfähigkeit.	Florian Menk Drei Bond GmbH
14.20 - 14.50	Effizientere Abdichtung elektronischer Bauteile mittels Low Pressure Moulding Formgebung und Abdichtung in einem Produktionsschritt ohne zusätzliche Reaktionszeit.	Paul Ranft OptiMel Schmelzgußtechnik GmbH
14.50 - 15.20	Prozesssicheres Dosieren beim Dichten, Kleben und Vergießen Effiziente Dosierteilprozesse für eine effiziente Wertschöpfung.	Alexander Huttenlocher RAMPF Production Systems GmbH & Co. KG
15.20 - 15.40	Kaffeepause und Netzwerken	
15.40 - 16.10	Mikrodosierungen in Perfektion ermöglichen Neue konstruktive Freiheitsgrade durch neue Dosierkonzepte.	Holger Eschenmüller ViscoTec Pumpen- u. Dosiertechnik GmbH
16.10 - 16.40	Podiumsdiskussion Konstruktive Herausforderungen in der Praxis	Dr. Michael Bosse SimpaTec GmbH Guido Brüggemann Guido Brüggemann Consulting GmbH Christian Geubert Angst + Pfister GmbH Marco Rodriguez as adhesive solutions e.K.
16.40 Uhr	Verabschiedung	

**Zur Anmeldung:** www.isgatec.com > Forum

Ihre Fragen beantwortet Sema Tatlıdede: +49 (0) 621-717 68 88-5

Wir danken unseren Event-Partner**pre-flow**
by ViscoTec**BERGER**
S2B